

北京赛微电子股份有限公司

2023 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

2、业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：8,803.33 万元~10,637.36 万元	亏损：7,336.11 万元
	比上年同期上升：220%~245%	
扣除非经常性损 益后的净利润	盈利：0 万元~1,139.55 万元	亏损：22,790.92 万元
	比上年同期上升：100%~105%	
营业收入	124,158.88 万元~128,087.96 万元	78,581.57 万元
	比上年同期上升：58%~63%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年报审计会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因为：

1、公司聚焦发展主营业务MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems，即微电子机械系统，简称为微机电系统），在工艺开发与晶圆制造方面均具备突出、领先的全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队，并在境内外同时布局扩张新的8英寸/12英寸产能，较好地把握了下游通讯、生物医药、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，订单饱满，生产与销售旺盛。

2、在原有境外扩产计划受挫之后，公司瑞典MEMS产线（FAB1&2）重新调整扩产方案，在2023年上半年完成收购产线所在的半导体产业园区，为业务扩展提供了可预期的空间条件，进一步巩固扩大了与客户的业务合作关系，瑞典产线的营业收入重回增长轨道，盈利能力亦得到显著恢复。

3、在经历多年积累之后，公司北京MEMS产线（FAB3）进入产能爬坡阶段，具有导入属性的工艺开发业务持续扩大，且从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加，北京产线的营业收入实现大幅增长，在客观面临折旧摊销压力、工厂运转及人员费用压力的情况下实现亏损收窄。

4、近年来，国际政治经济环境较为复杂，公司从境外增加了数批次半导体设备的战略性采购，在满足集团旗下产线自身中长期需要的同时，结合国内其他半导体制造厂商的需求新增了半导体设备销售业务，为集团贡献了一定体量的营业收入以及部分盈利。

5、公司参股子公司在本报告期内整体产生亏损。

本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为12,229.66万元，上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为15,454.81万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2023年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024年1月29日